

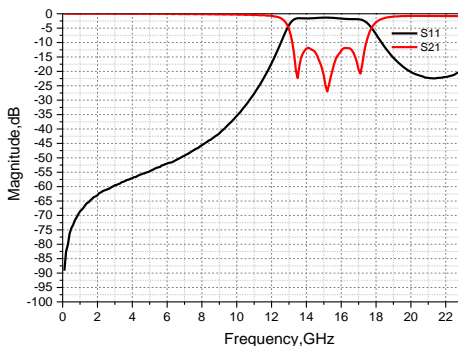
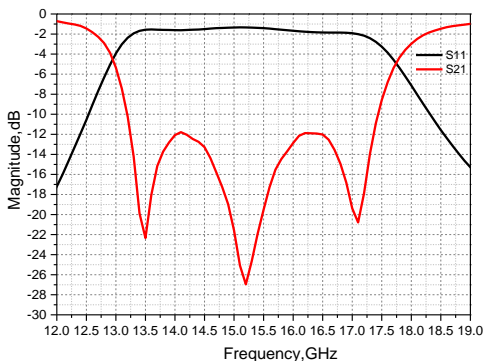
性能特点：

- 3dB 频率范围：13.2-17.2GHz；
- 通带损耗： $\leq 2\text{dB}$ ；
- 阻带衰减： $\geq 40\text{dB}$ (DC-9GHz)；
 $\geq 20\text{dB}$ (DC-12GHz)；
- 输入输出阻抗： 50Ω
- 芯片尺寸： $2.67\text{mm} \times 2.32\text{mm} \times 0.1\text{mm}$

产品简介：

HH-BP1317 型 GaAs MMIC 的 K 波段带通滤波器芯片的特点是窄带、频率选择性高，带外抑制强，且体积小，重量轻，适合应用于微系统集成的上下变频模块中及 TR 组件中。该芯片输入输出均为 50Ω ，设计上采用良好节地，使用方便，可采用共晶焊或导电胶粘结。

典型测试曲线：



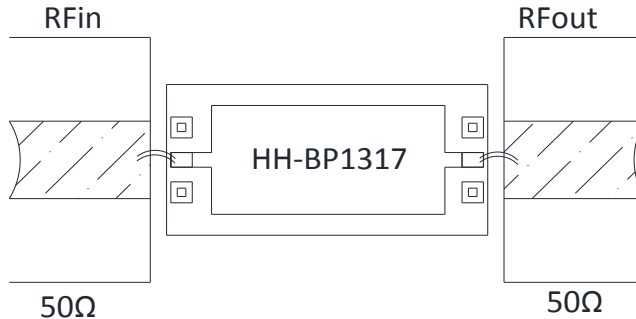
尺寸图：



说明：

1. 单位：毫米，公差： $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金，压点尺寸： $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

芯片装配图：



- 1、RFin 为信号输入端口，压点 1 通过两根金丝键和连接 50 欧姆微带线 1；
- 2、RFout 为信号输出端口，压点 2 通过两根金丝键合连接 50 欧姆微带线 2；
- 3、芯片背面及 50 欧姆微带线背面接地。

使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）